

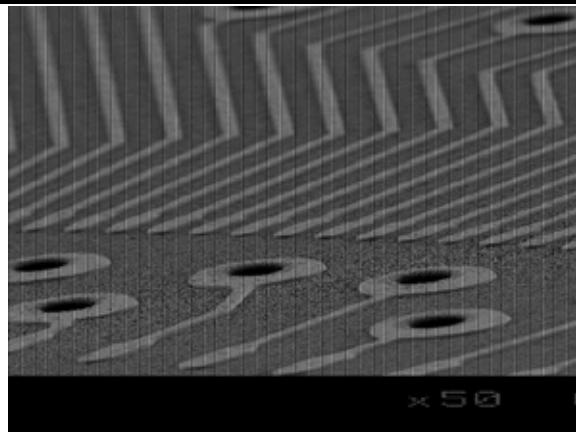
# 株式会社 リョウワ

当社の  
会社概要  
or  
得意技

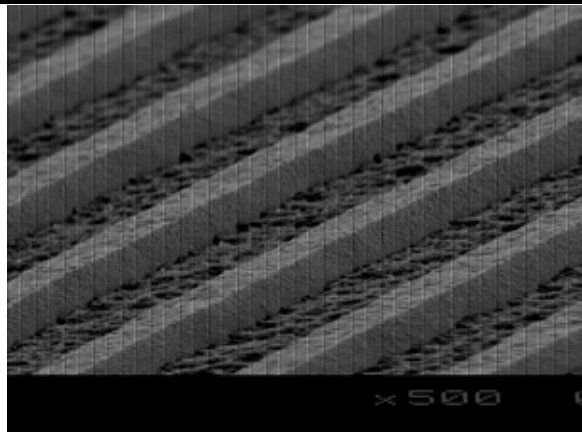
最新鋭の設備と固有技術による極薄・微細配線基板加工

## 概要

創業依頼一貫して薄板、微細配線加工技術を核として、国内半導体トップメーカー様をはじめ、国内外の半導体実装メーカー各社様との直接取引の他、半導体パッケージ基板では、世界トップに位置する基板メーカーへのOEM供給などを通して、市場の求める技術開発を行い、現在は厚み40 $\mu$ mの材料を使用した極薄基板、配線幅25 $\mu$ mの微細配線量産対応技術を確立しています。




半導体パッケージ基板銅配線



微細配線：配線幅/間隔幅=25/25 $\mu$ m

## 企業概況

会社名	 株式会社 リョウワ	代表者名	五味 達也
		窓口担当	営業部 久保川
事業内容	プリント基板製造・販売	URL	<a href="http://www.ryowacoltd.co.jp">http://www.ryowacoltd.co.jp</a>
主要製品	・半導体パッケージ基板 ・COB基板		
住所	〒391-0216 長野県茅野市米沢245		
電話/FAX	0266-73-5470 / 0266-73-3803	E-mail	kubokawa@ryowacoltd.co.jp
資本金(百万円)	78.5	設立年月日	1982年 9月
		売上(百万円)	3,740
		従業員数	135

特記事項 ①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績 他

- ① ISO9001:2008認証取得済み  
ISO14001:2004認証取得済み
- ② 半導体パッケージ基板製造ノウハウを活用した高品質プリント基板
- ③ 主要取引先 国内 株式会社ミズサワセミコンダクタ  
株式会社ジェイデバイス  
株式会社ミットヨ
- 海外 ChipMOS(台湾、上海)  
LINGSSEN(台湾)  
SEOUL SEMICONDUCTOR(韓国)